



2025 年 11 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社インターアクション
代表者名 代表取締役社長 木 地 伸 雄
(コード番号 7725 東証プライム市場)
問合せ先 社 長 室 I R 担 当
電話番号 045-263-9220

「SWTest Asia 2025」における 日本電子材料株式会社との共同技術発表について

当社は、本日開催された、アジア地域における半導体ウェハ及びダイレベルのテスト技術に特化した国際カンファレンス「SWTest (Semiconductor Wafer Test) Asia 2025」において、日本電子材料株式会社と共同で技術発表を行いましたので、お知らせいたします。

当社は、中期経営計画で「戦略的パートナーシップの構築」を掲げ、他社とのアライアンスを通じて、効率的な新規製品開発を目指しております。今後も積極的なパートナーシップ構築を通じて、企業価値向上に努めてまいります。

■発表内容

・タイトル

「New Method for Mounting Lens Module on Probe Card for CMOS Image Sensors testing」

・発表者

中島 智尚（日本電子材料株式会社）

堤 大樹（株式会社インターアクション）

・内容

従来の瞳モジュール®は、複数の部品で構成される専用治具でプローブカードに接続していました。そのため、治具の機械的ばらつきにより瞳モジュール®とセンサの位置ずれが生じていました。今回、瞳モジュール®を2つに分割し、一部のレンズをプローブカードに直接接続する技術を開発することで位置ずれを低減させることに成功しました。この新構造は、同時にレンズ及びプローブカード開口の小型化にも貢献します。

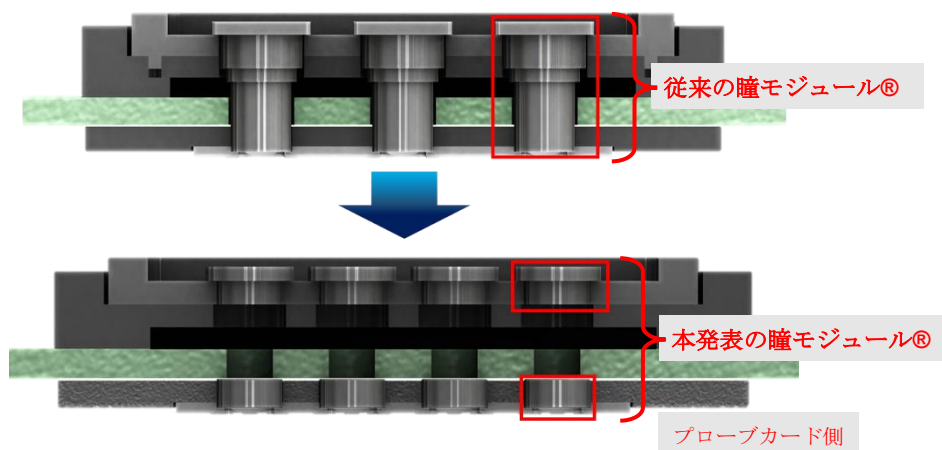


図 1：従来の瞳モジュール®と本発表の瞳モジュール®

・技術的価値

本発表技術を使用することで、瞳モジュール®の光学性能向上、同時測定数の増加、更にはプローブカードの電気特性向上が可能となります。これにより、より高品質かつ効率的なイメージセンサテスト環境の実現が期待されます。

<補足>

■「SWTest Asia 2025」について

概 要	「SWTest」は、米国で 30 年以上の歴史を持つ、半導体ウェハ及びダイレベルのテスト技術の国際カンファレンス。「SWTest Asia」はアジア地域を対象とした関連イベントで、昨年 2024 年開催時は 15 か国以上から約 700 名が参加。
開 催 期 間	2025 年 11 月 20 日(木)～11 月 22 日(土)
開 催 場 所	ヒルトン福岡シーホーク
発 表 日 時	2025 年 11 月 21 日(金) 14:00～14:30
プログラム詳細	https://www.swtestasia.org/program/

以上

お問い合わせ先

株式会社インターアクション 社長室 I R 担当 宛

TEL 045-263-9220 (代表) E メール：ir@inter-action.co.jp